



RE711001-LF

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Senza fori
- Stagnato a caldo (HAL senza piombo), rivestito con maschera di saldatura
- Stampa del componente
- Circuito con 57 esercizi di saldatura per l'introduzione nell'SMD--- | ---PLCC | 20, 68
 - QFP | 84 sq.
 - TSOP32 | 1 x
 - SO14 | 1 x
 - SOM16 | 1 x
 - SOL20 | 1 x
 - SOT23 | 3 x
 - SOT143 | 1 x
 - SOT89 | 2 x
 - SOT233 | 1 x
 - DPAK | 1 x
 - Poti. | 1 x
 - Tantal Chip Kond. A | 1 x
 - Tantal Chip Kond. B | 1 x
 - Tantal Chip Kond. C | 1 x
 - Tantal Chip Kond. D | 1 x
 - 1206 Chip Kond. | 10 x
 - 0805 Chip Kond. | 10 x
 - 1210 Chip Kond. | 6 x
 - 1812 Chip Kond. | 2 x
 - 2220 Chip Kond. | 1 x
 - 2308 Melf | 2 x
 - 1206 Mini Melf | 6 x
- Adatto anche per l'attrezzatura meccanica (Pick & Place)
- Dimensioni 100 x 140 mm

20190909